

## DATOS TÉCNICOS

---

<b>Temp boquilla</b>	215°C – 225°C
<b>Vel de Impresión</b>	20mm/s – 40mm/s
<b>Temp de plataforma</b>	25°C – 60°C
<b>Densidad</b>	1.37 g/cm <sup>3</sup>

## POLYDISSOLVE

PolyDissolve es una familia de filamentos de soporte solubles. Esta familia ofrece una solución de soporte para nuestra cartera de filamentos. Permite una mayor libertad de diseño. PolyDissolve S1 es un soporte soluble en agua para filamentos basados en PLA, TPU, PVB y nylon de nuestra cartera. Está diseñado específicamente para tener una interfaz perfecta con estos materiales y al mismo tiempo mostrar una buena solubilidad.

